

2012年3月14日

香港の子会社で半導体パッケージ用配線板材料の生産開始を決定 —約10億円を投じて設備を増強、今年7月よりサンプル提供開始—

日立化成工業株式会社(本社:東京、執行役社長:田中一行、資本金:155億円、以下、日立化成)の、プリント配線板用銅張積層板を製造する香港の子会社 Hitachi Chemical Electronic Materials (Hong Kong) Limited(以下、HCEM(HK))はこのたび、約10億円を投じて設備を増強し、半導体パッケージ用のプリント配線板用銅張積層板を生産することを決定しました。今年7月からサンプル提供を開始し、量産体制を整えます。

プリント配線板用銅張積層板は、PC向け半導体パッケージ、高速サーバーや携帯基地局向け等のハイエンド分野に加え、自動車部品、携帯電話およびサーバー向け等のミドルレンジ分野でも需要の増加が見込まれています。HCEM(HK)は昨年11月に、日立化成が出資比率を75%に引き上げ連結子会社化して以降、主にミドルレンジ分野の需要増に対応するために日立化成製品の生産を立ち上げてきました。一方、半導体パッケージ用製品を中心とするハイエンド分野については、日立化成の下館事業所および下館事業所(五所宮)(ともに茨城県筑西市)で製造し、需要の増加に応じて設備能力を高めてまいりましたが、震災以降、お客さまから生産拠点の複数化を求める声が高まっていました。

そこでHCEM(HK)は、約10億円を投じて設備を増強し、低熱膨張で高弾性という優れた特徴を持つ半導体パッケージ用のプリント配線板用銅張積層板を生産することを決定しました。今年7月からサンプル提供を開始し、量産体制を整えます。本投資により、半導体パッケージ用製品の海外生産が可能となり事業継続計画(Business Continuity Plan)の対応が図れるとともに、高品質が求められる半導体パッケージ用製品の生産体制を確立することで、ミドルレンジ分野の製品の生産においても効率向上や品質向上などのシナジーを生み出してまいります。また、プリント配線板の世界最大市場であり多くのお客さまが生産拠点を構える中国へ、短期間で製品供給が可能となるため、今後は、お客さまへのサービス体制を一層強化するとともに、引き続き成長が見込める中国市場での新規拡販を加速してまいります。

日立化成グループでは、日本、香港、中国(広州)にプリント配線板用銅張積層板の生産拠点を構え、今後も最適な生産体制の構築による生産効率向上と高品質な製品の供給を行ってまいります。

<HCEM(HK)の概要>

名称:Hitachi Chemical Electronic Materials (Hong Kong) Limited
(和名:日立化成電子材料(香港)有限公司)

所在地:Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, Hong Kong

代表者:董事長 中川 操

事業内容:プリント配線板用銅張積層板の製造および販売

資本金:13千香港ドル

設立:1985年(2011年11月より日立化成の子会社)

株主:日立化成工業株式会社 75%

従業員数:188名

投資額:約10億円

以上